

无锡芯朋微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

（2026年4月）

证券代码：芯朋微

证券简称：688508

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	博时基金 国联民生证券 鹏华基金 平安基金 嘉实基金 银河基金 长盛基金 开源证券 东海电子 招商证券 中邮证券 中泰电子 华泰资管 财通资管 财通基金 中金资管 恒大人寿 新华基金 申万菱信基金 诺安基金 创金合信基金 华安基金 西部利得 景顺长城基金 国联基金 长城财富
时间	2026年4月1日 2026年4月19日
地点	现场调研、电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、总经理 易扬波 董秘、财务总监 易慧敏 投资总监 刘权
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司基本情况介绍</p> <p>公司以“半导体能源赛道”为核心战略方向，专注于为客户提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司主要产品为高可靠性电源管理芯片、功率器件以及各类驱动产品，主要品类包括 AC-DC 电源产品线、DC-DC 电源产品线、Digital PMIC 电源产品线、驱动产品线、功率器件产</p>

品线和功率模块产品线等六大类，目前有效的产品型号超2,000款，全面覆盖服务器电源、通信、光伏/储能/充电桩、智能电网、工业电机、智能家电、智能终端的充电器适配器等众多领域。

公司 2025 年实现营业收入 11.43 亿元，同比增长 18.47%；归母净利润 1.86 亿元，同比增长 67.34%；扣非净利润 5587 万元，同比下降 23.59%。其中新兴市场（服务器、通信、工控、光储充、新能源车）营收同比大幅增长 50%；新品类（DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）营收同比增长 39%，业务结构向高附加值领域优化。2026 年第一季度实现营业收入 2.94 亿元，同比下降 2.57%；归母净利润 1372 万元，同比下降 66.59%；扣非净利润 1903 万元，同比下降 45.01%。

二、主要问题及回复

1、公司产品目前大概有多少的料号？

目前公司已开发超过 2000 个型号的产品，是国内少有的完整具备高低压电源芯片、高低压驱动芯片、功率器件、功率模块、电源电机功率系统芯片及解决方案的公司，尤其是高压 ACDC 产品具备国际一流水准，根据国际知名市场研究机构 Omdia 于 2024 年发布的行业统计报告中，芯朋微位列“AC-DC integrated switching regulators”产品大类的全球第二名。

2、公司新产品的进展情况？

公司持续升级的现有高低压集成核心技术平台，同时加大投入拓展了面向精密马达的低压电机驱动算法、数字电源多拓扑算法、新一代 FZVS 高效率电源架构技术、宽禁带器件智能化技术、大电流低压器件集成工艺技术等新的功率技术平台，从而公司产品线不断丰富，收入规模稳步上升。针对家电市场，公司在 AC-DC 产品已覆盖的整

机上搭配扩充电机 Driver 和电源 Driver (HV&LV) 的驱动产品系列、功率器件及模块系列；针对适配器市场，公司自主研发的高集成快充初级控制功率芯片、次级同步整流芯片及 PD 协议芯片的全套片方案逐渐上量，下游应用场景从 10W 到 140W、从智能超结器件到氮化镓，碳化硅器件全覆盖；针对工业级电源市场，面向 800V HVDC 系统的 1700V SiC 辅源、高压隔离驱动、霍尔抗强磁电源芯片、无电解电容 AC-DC 芯片、SiC/GaN 驱动等芯片、兆赫兹开环 DCX 控制器、全集成数字硬开关全桥控制器、8/12/16 多相 VRM、70/90ACu-Clip DrMOS、EFuse、PoL 等高性能功率产品全面进入量产，逐步收获市场认可。截至 2025 年，公司在国内首家形成面向服务器等工业电源市场一次、二次、三次电源的整套系统功率解决方案。公司始终有序的依托核心技术平台，不断拓展新的产品线，拓宽业务增长路径，扩大下游行业应用范围，实现阶梯式稳步增长。

3、2025 年度，公司知识产权情况？

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计取得国内外专利 129 项，其中发明专利 114 项，另有集成电路布图设计专有权 200 项。公司在模拟和数字电路设计、可靠性设计、半导体器件及工艺设计、器件模型提取等方面积累了众多核心技术，形成了完善的知识产权体系和独特的技术优势，多项芯片产品为国内首创，替代进口品牌，快速占领市场。

4、公司目前研发人员占比？

截至 2025 年末，公司研发人员达到 299 人，占公司员工比 69.86%。

5、2025 年度公司三个主要市场的营收情况？

工控功率类芯片：营收 2.1 亿元，同比增长 27.16%；

家用电器类芯片：营收 7.58 亿元，同比增长 22%；标准电源芯片：营收 1.7 亿元，同比小幅下滑 2.03%。

6、2026 年一季度利润总额及净利润变动原因有哪些？

公司 2026 年第一季度实现营业收入 2.94 亿元，同比下降 2.57%；归母净利润 1372 万元，同比下降 66.59%；扣非净利润 1903 万元，同比下降 45.01%。主要系：（1）报告期内出于谨慎性计提存货跌价准备，从而影响资产减值损失同比增加；（2）受二级市场股票价格影响，本报告期内公司持有芯联集成（688469.SH）股票产生公允价值变动损失。

7、公司未来发展战略情况？

市场方面，公司长期坚持和高度看好“半导体能源赛道”，以全面覆盖 AI 计算、电力能源、智能终端、智能家电和工业控制等五大重点市场应用领域为战略市场目标。公司工业领域自 2015 年开始布局，以智能电网终端为起点，经过多年研发投入，工控功率芯片进一步拓展到更多的工业应用领域，包括数据中心、通信基站、光伏逆变器、储能、工业电机、新能源车等大功率工业场景。公司接下来将加大在机器人和 AI 计算等新兴领域迭代升级，加速提升为客户提供一站式“Power System Total Solution”。

产品线方面，公司持续深耕“电源和电机功率系统芯片及解决方案”战略，目前已基于五大核心技术（高低压集成工艺、智能功率器件、数模混合功率设计、多学科失效分析、高密度功率封装）构筑出六大具备协同效应的产品线（AC-DC、DC-DC、Driver、Digital PMIC、Power Device、Power Module）架构。目前公司已开发超 2,000 个型号的产品，在高低压集成半导体技术领域处于行业领先地位，公司将通过持续创新的高效能、高集成及高可靠的智能化

	产品与技术, 未来三年, 基于全面升级的 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart-GaN 的全新智能功率芯片技术平台、多相数字技术平台和 DrMOS 特殊工艺技术平台, 满足终端整机系统不断升级的能源挑战, 以先进芯片驾驭电能, 把智慧能源普惠到每个人。
附件清单 (如有)	
日期	2026.4